

+ + + Presse-Information HEITEC AG + + +

HEITEC auf der “embedded world 2024” – Highlights:

Vorstellung einer neuen, schwarzen Industrie-PC Gehäuselinie für den kundenspezifischen Ausbau

Exponate mit unterschiedlichen Wertschöpfungstiefen und Beispieldemos aus verschiedensten Märkten unterstreichen die Vorzüge maßgeschneiderter Systemintegration

... Eckental, 25. März 2024 – Auf der „embedded world 2024“ in Nürnberg (9. bis 11. April 2024) stellt HEITEC in Halle 5 / Stand 5-121 neben Neuheiten im Baugruppenträger-Programm – darunter eine neue, schwarze Industrie-PC Gehäuselinie – aktuelle, maßgeschneiderte Systemlösungen unterschiedlicher Integrationsstufen für verschiedene Anwendungsbereiche wie Verkehrstechnik, Medizintechnik und Energietechnik vor. Diese veranschaulichen den Weg von der Konzeption über Design, Fertigung und Test bis hin zum Lifecycle-Management, was auch Redesigns und die besonderen Kriterien umfasst, die dabei zu erfüllen sind.

Neue IPCs und Baugruppenträger für modulare Lösungen und schnelle Marktreife

HEITEC präsentiert erstmals eine Industrie-PC-Gehäuselinie in smartem Schwarz. Bestehend aus drei Varianten bietet sie unterschiedliche Ausstattungsmerkmale wie Frontanschlüsse für schnelle Konnektivität oder abschließbare Frontklappen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff – perfekt für die Industrie, den Medizinbereich und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

... Die hochbelastbaren IPCs in 4 HE sind für den Einbau in 19“-Schränke und die bedarfsgerechte Aufnahme von Erweiterungskarten ausgelegt. Sie werden inklusive Lüfter, Slot-Abdeckung und optional mit USB-Frontanschlüssen sowie komplett vormontiert, verdrahtet und geprüft ausgeliefert. Zwei Varianten sind ideal für lange Einsatzzeiten geeignet, da Filtermatten und Lüfter während des Betriebs ausgewechselt werden können. Umfangreiches Zubehör macht alle IPCs zu anpassungsfähigen Multitalenten für verschiedenste Anwendung, unabhängig davon, ob hohe CPU- und Grafikpower, kontinuierlicher Betrieb oder Ausfallsicherheit erforderlich sind. Mit ihrem Look entspricht die Linie außerdem den vermehrten Wünschen der Kunden nach ansprechenden Designs, die nun an die Erwartungen der Endkunden angepasst sind, einladend wirken und die sich optisch am Consumer-Markt orientieren. Individuelle Anpassbarkeit, Farbgestaltung und Beschriftung sind selbstverständlich ebenfalls möglich.

Aus dem Baugruppenträger-Programm dienen zwei 12 HE HeiCases als Gehäuse für 3 der neuen IPCs und eine fortschrittliche HeiCool-Lüfterlösung, um die Flexibilität der Linie für modulare und komfortable 19“-Designs zu unterstreichen und die damit verbundene Variabilität aufzuzeigen. Die HeiCase-Linie besticht durch ihre moderne, dabei überaus stabile Konstruktion und ihre hohe Funktionalität. Mit umfangreichem Zubehör ist sie bereit für individuelle Konfigurationen und Erweiterungen. Neu sind hier schwarze Dekorelemente und Rollen aus Gummi, für Schwerlast und in ESD-Ausführung.

Optimierte Hardwareleistung und geringere TCO durch FPGAs und Module

Beispiele von Modul-, Board- und FPGA-Designs (Field Programmable Gate Arrays) sind ebenfalls zu sehen. HEITEC nutzt das Potenzial und die Vielseitigkeit von FPGAs und Modulen, um für seine Kunden effiziente Hardwarelösungen zu realisieren. Sie haben sich als nützliche Helfer bewährt, um Hardware-Funktionalitäten maßgeschneidert anzupassen, zu optimieren und zu erweitern. Mit ihrer Hilfe lassen sich Systemdesigns zukunftssicher und leistungsfähiger bei geringeren Systemgesamtkosten (Total Cost of Ownership) gestalten.

Maßgeschneiderte Systemintegration: Beispiele aus verschiedenen Industriesparten

Anhand einer Reihe von branchenspezifischen Exponaten aus den Bereichen Verkehrstechnik, Medizintechnik und Energietechnik demonstriert das Unternehmen seine Expertise in der Realisierung maßgeschneiderter Module und Systeme unterschiedlicher Ausbaugrade. Diese bestehen aus exakt den Anforderungen entsprechenden, verschieden großen Anteilen von Software, Mechanik und Elektronik, Standardkomponenten und individualisierten Designs. Die Lösungen werden unter zertifizierten Bedingungen und mit etablierten Prozessen konzipiert, entwickelt, geprüft, getestet und gefertigt und spiegeln die Bündelung hauseigener Synergien wider, um die Kosten möglichst gering zu halten. Ein Fokus liegt dabei auch auf den Themen Änderungs- und Modernisierungs- sowie Obsoleszenz-Management und der wichtigen Rolle der Testkapazitäten zur Qualitätssicherung, insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen regulierter Branchen.

Standort: Halle 5 / Stand 5-121

Ansprechpartner vor Ort: Lisa Richter

Weitere Informationen:

<https://elektronik.heitec.de/de/landingpages/embedded-2024>

Firmenprofil der HEITEC AG

HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung, Elektronik sowie Anlagen- und Sondermaschinenbau und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mit technisch hochwertigen, verlässlichen und wirtschaftlichen Lösungen unterstützt HEITEC über 2.000 Kunden, ihre Produktivität zu steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1.200 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz.

Im Kompetenzzentrum für Elektronik entwickelt und fertigt HEITEC kundenspezifische Elektronikprodukte und -systeme vom einfachen Board bis hin zu komplexen Systemen bestehend aus Hardware, Embedded Software, Applikations-Software und Gehäusetechnik. HEITEC verfügt über ein profundes, technisches Spezialwissen und kennt auch die spezifischen Anforderungen regulierter Branchen. Unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse sind darauf abgestimmt, auditiert und zertifiziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.heitec.de/>

Ansprechpartner HEITEC AG**Business Unit Electronics**

Lisa Richter

Dr.-Otto-Leich-Str. 16

90542 Eckental

TEL +49 9126 2934-142

MAIL elektronik@heitec.de

WEB <https://elektronik.heitec.de>

Pressekontakt**MIKE ROTH - Concept. Artwork. Publishing.**

Sylvia König

Rosenheimer Straße 32

83083 Riedering

TEL +49 89 58966720

MAIL skoenig-pr@mikeroth.de



Bild:

der neue HEITEC-Messestand in Halle 5, Stand 5-121